

半导体

台积电限制大陆 IC 设计流片封装，国产替代有望加速

事件：近日，台积电向一大批中国大陆的 IC 设计公司发出正式通知：从 2025 年 1 月 31 日起，若 16/14 纳米及以下的相关产品未在 BIS 白名单中的“approved OSAT”进行封装，且台积电未收到来自该封装厂的认证签署副本，这些的产品发货将被暂停。

1. 台积电正进一步配合美国 BIS 对中国大陆半导体进行制裁

根据集微网，1) 大陆多家 IC 设计公司表示，目前的确需要将规定内的芯片转至美国 approved 封装厂做封装。对于那些事先已有该封装厂账号的公司而言，受到的影响相对较小；而那些没有账号的公司，则面临着严重影响交货时间的困境。2) 部分大陆 IC 设计公司还被要求将部分敏感订单的流片、生产、封装和测试全部外包，并且 IC 设计公司在整个生产流程中不能进行干预。这些限制或使大陆先进制程芯片的生产和封装环节变得更加透明，中国大陆半导体产业的技术保密性和发展自主性或将受到影响。

2. 为中国大陆半导体产业带来的影响与机遇

短期来看，1) 公司原本的生产计划被打乱，交货时间有可能延迟，新产品上市时间可能推迟，不仅面临客户流失的风险，还可能在市场竞争中处于劣势；2) 公司需要寻找新的芯片代工厂和封装测试合作方，这其中也需要投入大量的成本与时间；3) 大陆半导体技术链可能出现断层。按照摩尔定律，制程节点每提升一代，芯片性能便能提升约 40%。受到影响的企业，其 AI/HPC 芯片或难以与市面上采用更先进制程芯片的产品抗衡。

长期来看，外部地缘政治影响带来的不确定性有望加快中国大陆半导体产业链国产替代的步伐。1) 大陆晶圆代工厂：中芯国际作为大陆本土晶圆厂有望迎来更多的市场机会，中芯国际已具备量产 14nm 工艺芯片的能力，有望在更先进的工艺上有所突破，我们认为，原本流向台积电的部分订单可能流入中芯国际；2) 国产半导体材料供应商：如果大陆晶圆代工厂接到更多流片订单，国产半导体材料供应商就有望迎来更多供货机会，半导体材料作为半导体产业的基石，自主可控重要性凸显，国产替代进程有望加速；3) 国产半导体设备及零部件供应商：我们认为，面对新增订单，大陆晶圆代工厂有可能扩产先进制程产能，半导体设备及零部件供应商有望接到更多订单。

建议关注：

- 1) **IDM 代工**：中芯国际/华虹半导体/士兰微/时代电气/扬杰科技/闻泰科技/三安光电
- 2) **半导体材料**：清溢光电/路维光电/龙图光罩/雅克科技/鼎龙股份（天风化工联合覆盖）/和远气体/沪硅产业/上海新阳/安集科技/中巨芯/有研新材/华特气体/南大光电/凯美特气/天岳先进/艾森股份/江丰电子
- 3) **半导体设备零部件**：正帆科技（天风机械联合覆盖）/北方华创/富创精密/精智达/中微公司/盛美上海/金海通（天风机械联合覆盖）/鸿日达/精测电子（天风机械联合覆盖）/国力股份/新莱应材/长川科技（天风机械覆盖）/联动科技/茂莱光学

风险提示：地缘政治带来的不可预测风险，需求复苏不及预期，技术迭代不及预期，产业政策变化风险。

证券研究报告

2025 年 02 月 10 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517070005

panjian@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:美对华半导体出口管制落地,A 股进入业绩预告期》
2025-01-22
- 2 《半导体-行业研究周报:关注美总统换届前后对华半导体政策的变化》
2025-01-17
- 3 《半导体-行业研究周报:手机等产品购新补贴或拉动半导体需求》
2025-01-09

图 1: Approved OSAT (图右)

IC Design	OSAT
Advanced Micro Devices, Inc.	Amkor Technology, Inc.
Alphabet, Inc.	Ardentec Corporation
Amazon.com, Inc.	ASE Technology Holding Co., Ltd.
Analog Devices, Inc.	Doosan Tesna, Inc.
Apple, Inc.	Fabrinet
BAE Systems, Inc.	Giga Solution Tech Co., Ltd.
Block, Inc.	GlobalFoundries, Inc.
The Boeing Company	HT Micron Semicondutores SA
Broadcom, Inc.	Intel Corporation
Cerebras Systems, Inc.	IBM (International Business Machines)
Cisco Systems, Inc.	KESM Industries Berhad
Hewlett Packard Enterprise Co.	LB Semicon, Inc.
Honeywell International, Inc.	Micro Silicon Electronics Co., Ltd.
Infineon Technologies AG	Nepes Corporation
Intel Corporation	Powertech Technology, Inc. (PTI)
IBM (International Business Machines)	QP Technologies
L3Harris Technologies, Inc.	Raytek Semiconductor, Inc.
Marvell Technology, Inc.	Samsung Electronics Co., Ltd.
MediaTek, Inc.	SFA Semicon Co., Ltd.
Meta Platforms, Inc.	Shinko Electric Industries Co., Ltd.
Micron Technology, Inc.	Sigurd Microelectronics Corporation
Microsoft Corporation	Steco Co., Ltd.
Mitsubishi Group	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC)
Nokia Corporation	United Microelectronics Corporation (UMC)
Nvidia Corporation	
NXP Semiconductors NV	
Qualcomm, Inc.	
Raytheon Company	
Realtek Semiconductor Corporation	
Sony Group Corporation	
Tesla, Inc.	
Texas Instruments	
Western Digital Technologies, Inc.	

资料来源：集微网，天风证券研究所

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com